

国家“芯火”双创西安基地参加 “芯火”双创基地建设推进工作会



1月14日，国家“芯火”双创西安基地（平台）总经理吕卓辉、产业服务部部长赵城一行前往厦门参加“芯火”双创基地建设推进工作会。“芯火”创新建设专家组专家，北京、上海、南京、无锡、杭州、西安、深圳、成都等来自10个城市的国家“芯火”双创基地代表参会。

首先，厦门基地负责人带领各基地代表们参观了厦门国家“芯火”双创基地核心区，并向来宾详细介绍

了基地的建设情况、运营模式及发展规划等内容。

随后，国家“芯火”双创基地建设推进工作会在厦门悦华酒店召开。参加会议的有工业和信息化部电子信息司处长俞晓杰、“芯火”创新计划建设专家组组长、浙江大学教授严晓浪，“芯火”创新计划建设专家组副组长、中国半导体行业协会专家委员会副主任陈晋，“芯火”创新计划建设专家组副组长、中国电子信息产业发展研究院集成电路研究所所长王世江，厦门市工业和信息化局副局长李建明及厦门市工业和信息化局电子信息处处长陈志萍等。

会议由俞晓杰处长主持。各国家“芯火”双创基地代表分别就各自建设情况及下一步工作计划展开充分交流。国家“芯火”双创西安基地代表赵城就西安本地的产业现状、基地目前的工作进展及未来的发展三个方面做了详细的汇报。

会议的最后，工信部电子信息司负责人、“芯火”创新建设专家组专家分别对基地建设做出点评。工信部电子信息司领导充分肯定了各“芯火”双创基地取得的积极成效。他表示，集成电路是整个电子信息产业的“粮食”，“芯火”基地也是产业公共服务平台，希望大家把握机遇，结合各地优势形成特色，培育打造自主产业链。同时，要对标先进，加大国际学习交流，坚持合作开放。相信未来各“芯火”双创基地将为集成电路产业发展贡献更多力量。

西安工业投资集团有限公司党委书记董事长金辉一行 调研西安集成电路设计专业孵化器



3月10日，西安工业投资集团有限公司党委书记董事长金辉一行莅临西安集成电路设计专业孵化器有限公司调研指导工作，这是自我司移交西安工业投资集团有限公司后，集团领导的首次到访。

集团领导一行首先参观了集成电路孵化器的办公场所、工作环境、测试实验室、EDA设计室、嵌入式软件培训教室。

在随后召开的座谈会上由集团副总经理任广斌主持，集团党委书记董事长金辉、纪委书记常以卓、经济运行部、投资发展部、财务管理部、政策法规部、组织人事部、办公室等集团相关部门负责人参加此次会议。

西安集成电路设计专业孵化器总经理围绕公司基本情况、发展历程、人员构成、业务开展及面临的困难等方面进行了汇报。

金辉通过对集成电路孵化器的基本情况、行业地位和区域内的行业职能进行了深入的了解，表示要发挥“国家芯火创新平台”的作用，落到实处，要将平台掌握的科技、信息等资源，通过利用工投的资源，实现与本地传统工业的对接，把企业做的更大更强。

陕西省2020年重点项目计划出炉 三星12英寸闪存芯片二期二阶段入列

3月10日，省发展改革委正式发布陕西省2020年省重点项目计划，确定实施600个省重点项目，其中续建项目312个、新开工项目188个、前期项目100个，项目总投资3.4万亿元。

新开工的“三个经济”发展工程项目35个，以交通基础设施、现代服务业、总部经济项目为主。

新开工的创新驱动发展工程、产业转型升级工程项目共105个，包括三星(西安)12英寸闪存芯片(二期)二阶段、陕煤榆神煤业及热解深加工工程、榆林矿业集团400万吨煤炭间接液化3个投资额均超过500亿元的大型项目。

省重点项目建设项目中，西安宝能新能源汽车产业园、西安尹鹏通讯云大数据中心、西咸中兴深蓝科技产业园、陕北至武汉±800千伏特高压直流输电工程，以及高铁等新型基础设施建设工程为我省追赶超越发展注入新动能。

另外，现代农业与骨干水利、区域协调发展、文化旅游发展、社会事业与民生改善也是2020年项目建设的重点领域。

为强化金融支持，推动重点项目加快建设，省发展改革委协调国家开发银行陕西省分行、中国进出口银行陕西省分行、中国农业发展银行陕西省分行设立融资总额达1200亿元的应急专项资金，支持疫情防控重大项目和省重点项目建设。经省发展改革委与3家政策性银行共同努力，317个项目已进入办贷程序。

省发展改革委与建设银行陕西省分行、工商银行陕西省分行建立了应对疫情加快重点项目投融资保障对接机制，分别设立1000亿元的应对疫情促复工专项信贷资金和不低于300亿元的表内外信贷，支持我省重点项目、疫情防控重大项目开工建设，竣工重点项目复工复产释放产能，推动全省经济平稳健康发展。

来源：三秦都市报

总投资5亿元，陕西光电子集成电路先导技术研究院南区项目开工



3月29日，西安高新区10个项目集中启动开工，其中包括陕西光电子集成电路先导技术研究院南区项目。

据陕西传媒网报道，陕西光电子集成电路先导技术研究院南区项目，总投资5亿元。项目将建立院地融合创新平台，统筹学科、人才、技术优势及军民结合等资源，打造国内首家以政—产—研—资—用—研相结合的光电子集成产业创新型服务平台。

陕西光电子集成电路先导技术研究院由中科院西安光机所、陕西省科技厅、西安高新区、西安电子科技大学、西安邮电大学、中科院蓝光科技孵化器共同发起成立。据其官网介绍，先导院最大的特点是项目团队、企业需求为出发点，并在此基础上搭建的公共服务平台。先导院占地83亩，建筑面积2.1万平方米，拥有先进设备仪器2000多台(套)。

此外，在2016年8月，中国科学院西安光学精密机械研究所、陕西省科技厅、陕西光电子集成电路先导技术研究院共同发起设立了“陕西光电子集成电路科技专项基金”，基金总额10亿元，专注于高端光电子集成电路领域孵化转化。现已投资孵化化硅光子集成传感芯片、InP外延材料、霍尔传感器等20余个项目，同时储备国内外100余个高水平创业项目。

来源：集微网

西安一季度162个重点项目集中开工 先进制造业项目29个



3月17日上午，西安市举行第一季度重点项目集中开工仪式，162个重点项目集中开工，总投资1503亿元，年度投资500亿元。

据悉，参加本次集中开工的项目涵盖了先进制造业、现代服务业、城建及基础设施、生态环保和社会事业民生保障5大领域。这些项目中，总投资30亿元以上的项目达11个，10亿元至30亿元项目45个，5亿元至10亿元项目23个。

开工仪式上，西安市发展和改革委员会主任邢欣介绍了本次项目的基本情况；其中，先进制造业项目29个，总投资207亿元，年计划投资56亿元。主要有：总投资48亿元的西安电子谷二期项目，总投资17.5亿元的西安标雄厂搬迁项目，总投资16亿元的三星环新一工厂产能升级改造项目，总投资14.8亿元的高科建材新材料产业园，总投资10亿元的经开区欧中生物技术产业化，总投资10亿元的航天基地新经济产业园等项目。

服务业项目28个，总投资384亿元，年计划投资107亿元。主要有：总投资29亿元的中国电建西北总部项目，总投资28亿元的航天基地金辉天字二期广场项目，总投资25.5亿元的曲江·流光山谷创意产业园，总投资20亿元的中国中铁丝路总部基地，总投资15亿元的秦商国际中心，总投资14亿元的西安软件科技大厦项目等。

城建及基础设施项目26个，总投资109亿元，年计划投资53亿元。主要有：高压线配套电力沟道项目、欧亚四路跨河桥接项目、西安航天基地旧城区市政基础设施提升改造项目、碑林区新头路打通项目、西咸新区科创大道、长兴大街、洋东四路项目等。

生态环保项目16个，总投资35亿元，年计划投资22亿元。主要有：经开区景观绿化及环境提升工程、浐河

灞桥区段右岸景观绿化提升工程、南三环北辅道曲江景观绿化提升工程、长安区1号河综合治理工程、天桥湖水利水基础设施建设项目等。

民生类项目63个，总投资768亿元，年计划投资262亿元。主要有：西安市红十字会医院高新院区建设项目、新城区老旧小区改造工程、郭家堡城改项目、长安区老旧小区改造综合提升项目等。

除了本次参加集中开工的162个项目之外，疫情防控期间，高新区、经开区、雁塔区、蓝田县等区县、开发区相继举行了重点项目开工仪式。全市还有116个新建项目已启动建设，总投资约1511亿元，年度计划投资约284亿元。

参加本次集中开工的项目主要有以下四大特点。

一是补民生短板。此次集中开工项目中涉及社会事业和民生保障项目有63个，总投资768亿元，项目个数和总投资分别占总投资的39%和51%。特别是新城区、莲湖区、雁塔区、未央区、长安区等区域一大批老旧小区改造项目相继启动，还有五里小学、泾河新城第三中学、航天城第二中学等一批学校建设项目加快建设，都将有效改善人居环境，稳步提升民生保障水平。

二是重大项目引领。这次开工的项目中，涉及先进制造业项目29个，总投资207亿元，总投资过10亿元的项目有8个，占近三分之一。尤其总投资48亿元的西安电子谷二期项目，是西安高新区与西安电子科技大学合作共建的校地融合发展产业加速平台。项目建成后，将成为西安市电子信息产业集群化发展的重要引擎；还有总投资16亿元的三星环新一工厂产能升级改造项目，总投资14.8亿元的高科建材新材料产业园，总投资10亿元的经开区欧中生物技术产业化，总投资10亿元的航天基地新经济产业园等项目启动建设将为西安经济注入新的增长动力。

三是优化营商环境。围绕城市基础设施的短板，采取积极有效措施，全力推进架空线缆落地、城市功能提升、通行道路建设、黑臭水体治理、景观绿化及环境提升工程等项目加快建设，进一步完善城市基础设施，打造优美、舒适、安全的城市环境。

四是大项目增多。本次集中开工的项目中，总投资10亿元以上的项目达到56个，占项目总量的35%，其中，30亿元以上的项目达11个；5亿元至10亿元项目23个。

来源：三秦都市报



西安设立“市长特别奖” 获奖者奖励50万元

近日，《西安市“市长特别奖”实施办法》正式印发。市委、市政府决定设立“市长特别奖”，进一步激励广大企业家、管理（科研、项目）团队和个人聚力先进制造业强市建设和文化旅游经济发展，积极打造我市现代产业体系，加快建设国家中心城市，实现追赶超越目标。

《办法》明确，设立“市长特别奖”，名额不超过20名，每名获奖人员（团队）奖励50万元；设立“市长特别奖提名奖”，名额不超过30名。

申报范围包括产业体系建设、创新驱动、招大引强三个方面。其中，产业体系建设方面是指在做强6大制造业支柱产业、做大5大新兴产业、做优6大生产性服务业、做精文化旅游产业等现代产业体系（简称“6+5+6+1”）建设中，带动作用强、税收贡献大、产业辐射广、吸纳就业多，做出突出贡献的企业主要负责人或管理团队。创新驱动方面是指在制造业关键核心技术攻关、科技成果转化、新产品开发、传统产业转型升级等方面做出突出贡献的核心人物或研发团队。招大引强方面是指在积极推动重大招商引资制造业项目落地，突出产业链配套，在延链、补链、育链、强链等方面，对增强全市工业发展后劲做出突出贡献的项目投资团队或个人。

《办法》明确，申报条件为：具有较高政治素质，能认真贯彻落实中央和陕西省、我市各项决策部署，爱国爱党、遵纪守法，自觉履行社会责任，具有良好公众形象。推动全市经济社会高质量发展，特别是聚集全市先进制造业强市，勇于担当实干、创新突破、奋勇争先，社会认可度高、行业影响力大、综合实力强。对全市经济社会发展支撑作用明显。近三年来，企业未发生重大环境污染、产品质量、生产安全和失信、劳资冲突等违法违规问题，劳动关系和谐，职工队伍稳定，诚信记录良好。担任董事长、董事会（局）主席、首席执行官、总裁、总经理、厂长、经理。研发或项目团队主要负责人等职务或在做出特别突出贡献的岗位任职两年以上。每个企业、项目、科研院所等只能申报1名人员（团队）。

评选坚持公平、公正、公开的原则，聘请第三方机构，通过社会推荐、网上投票、征求意见、结果公示的方式进行评选。市委、市政府向获奖人员（团队）颁发“市长特别奖”和“市长特别奖提名奖”荣誉证书、奖杯及奖金。在申报过程中，对弄虚作假或故意隐瞒真实情况骗取荣誉和奖金的，一经发现，取消资格，追回奖励资金，并按有关规定严肃处理。

来源 西安报业

《西安市加快5G系统建设与产业发展的实施意见》发布

4月21日，《西安市加快5G系统建设与产业发展的实施意见》印发，全方位推进5G在先进制造、智慧城市、智慧交通等各个领域的融合创新应用，助推西安“三个经济”发展，将我市打造成为网络基础完备、应用场景丰富、独具特色的5G产业创新发展高地。

2020年新建5G基站9000个

到2022年，5G网络覆盖面积和建设水平中西部领先，5G产业规模显著增大，5G技术在经济社会各领域得到广泛应用和深度融合，5G产业生态体系日趋完善，力争成为5G网络建设先行区、产业发展集聚区及5G创新应用示范区。

大力推进系统建设。2020年，新建5G基站9000个，累计建成13000个，实现核心城区和全运会场馆、重点产业集聚区、交通干线、旅游景点等重点区域5G信号连续覆盖。2021年，新建5G基站7000个，累计建成20000个，全市完成5G网络组网，主要城区实现5G网络连续覆盖。2022年，新建5G基站5000个，累计建成25000个，远郊区县重点区域开通5G网络及商用，实现涉农区重点区域5G信号覆盖。

重点推动产业发展。力争在我市构建覆盖5G上、中、下游产业的较为完备的产业链。在细分领域形成一批特色产品，实现5G产业聚集发展。在关键器件和芯片、网络设备、智能终端、新材料、天线、应用软件、网络安全等领域培育一批龙头企业和重点项目，加快科技成果转化。到2022年底5G产业规模超过300亿元，成为我市先进制造业发展的重要力量。

这份意见还包含了哪些举措？下面进一步解读：
免费开放行政机关非涉密公共区域及设施资源
 西安将按照“规划先行、需求引领、分步实施”的原则，明确5G系统建设相关标准，编制编制5G基站站址专项规划，并做好与国土空间规划、控制性详细规划的衔接。统筹、科学、合理布局5G基站，数据中心、边缘计算设施、通信机房、智慧多管杆塔及通信管道等信息基础设施，实现共建共享。免费开放行政机关、企事业单位、公共机构非涉密公共区域及设施资源，开放公交站台、地铁、机场、港口、客运站场、城市道路、桥梁隧道、地下管廊等市政公用区域和设施，支持5G及通信网络配套设施建设。加快推进电力、通信、市政、交通、公安视频监控等各类杆塔资源整合共用，强化用地保障，做好产业规划与国土空间规划的衔接工作，将5G特色产业聚

集区纳入新一轮国土空间规划编制工作，确保优质项目用地需求。

将5G产业打造成为我市先进制造业发展的重要力量。支持高等院校、科研院所等研发创新机构和龙头企业，在网络架构、射频芯片及模组、微波器件及天线、测试技术及装备、新材料等5G产业核心技术上取得突破。推进5G与云计算、大数据、物联网、人工智能等技术融合创新，通过基于5G网络的各类场景应用和垂直行业应用，研发一批“5G+集成应用”技术和应用软件。支持网络安全企业加强5G安全标准与产品研发，增强5G产业安全技术支撑能力，培育壮大若干5G网络安全龙头企业，加强供需对接、产融结合，促进形成先进5G产业核心技术竞争力。

形成5G产业集聚促进5G创新成果转化地

围绕5G重点发展方向，汇聚产业要素，完善功能保障，加快推进5G研发基地、生产基地和应用基地建设。支持有条件的区县、开发区设立5G产业园，吸引5G关键器件和芯片、网络设备、智能终端、新材料、天线、应用软件、网络安全等产业各环节优质企业落户，促进形成特色鲜明、功能完善的5G产业集聚区。

推进5G在全运会赛事方面的应用打造“5G全运”

在先进制造、智慧城市、智慧交通、文化创作等方面率先开展5G应用。在电子信息、汽车制造、航空航天等重点领域开展基于“5G+工业互联网”的先进制造示范应用。

推进5G在全运会赛事直播、新闻报道、全运会场馆安保等方面的应用。打造“5G全运”，推进5G网络与超高清视频、AR/VR、车联网、无人机、人工智能等技术结合，提升群众在政务服务、文体娱乐、智能出行、智慧社区等应用场景下的体验。

5G基站转供电收费标准原则上按正常商业用电价格

我市建设先进制造业强市的政策举措全面适用于支持5G产业发展。在市工业发展专项资金中设立5G产业发展专项，用于支持5G网络建设、产业研究、技术研发、产品开发、产业招商引资、重大项目建设、技术改造、产业集聚区建设、配套体系建设及创新应用推广等方面，加强在偏远地区城市绿地、公园等特殊公共区域基站建设的政策支持力度。

来源 西安发布

《西安市科技金融融合业务补助实施办法》出台 对硬科技企业实施金融融合业务补助

1月5日，记者从市科技局获悉，为了积极探索政府财政资金支持创新驱动发展新路径，引导金融资源向科技领域配置，拓宽融资渠道，降低融资成本，促进我市科技企业创新发展，《西安市科技金融融合业务补助实施办法》出台。

科技金融融合业务补助，是指对获得科技金融融合业务支持的科技企业和为我市科技企业提供科技金融融合业务服务的合作机构给予的贴息、补助及奖励等政策支持。具体包括流动资金贷款贴息、担保补助、科技保险保费补助、天使投资奖励等形式。科技金融融合业务补助采取后补助方式，每年通过市金融发展专项资金中列支，由市科技局会同市财政局通过年度预算进行安排。

流动资金贷款业务补助包括：短期流动资金贷款业务补助和中期流动资金贷款业务补助两种，具体业务补助支持方式包括贴息补助、担保补助等。科技保险保费补助是指对于参加科技保险的科技企业，按照保费的一定比例给予保费补助支持。天使投资奖励是指对于在市科技局备案的天使投资机构，投资于注册地和纳税地在我市辖区，成立时间5年以内，年审计销售收入不超过5000万元（含）人民币的高新技术企业，未获得市财政同类奖励支持的，按照本办法给予投资奖励。奖励额度为实际投资额的1%，单笔单户不超过20万元。每家投资机构每年累计补助最高不超过300万元。

申请业务补助的科技企业应由西安科技金融服务中心有限公司审核并出具推荐函确认。具体要求为：注册地和纳税地在西安市辖区，无不良记录，未列入经营异常名录和违法失信企业名单；符合集成电路（光电芯片）、信息技术、生物技术、人工智能、智能制造、航空航天、新材料、新能源等硬科技产业领域；科技企业按办法以无形资产（包括专利、商标、植物新品种、集成电路布图设计、计算机软件著作权、应收账款、股权等）质押，通过担保、保险或者银行直贷获得贷款融资等；推荐日上年度销售收入在4亿元（含）以下（以担保公司审核的收入或无担保贷款银行审核的收入为准）。同时，未出具推荐函，但未认定的高新技术企业和列入上市科技企业培育数据库、定期报送有关资料的科技企业也可以申请。

来源：西安新闻网

国家半导体照明产品质量监督检验中心（陕西）通过评审

近日，陕西省计量科学研究院承担的国家级国家半导体照明产品质量监督检验中心（陕西），通过了国家认证认可监督管理委员会专家评审组的资质认定现场评审。

据悉，在评审现场，评审组通过听取筹建工作汇报、审阅技术文件、查阅记录、查看设施设备、现场提问等方式，对中心申报的两大类15种产品、840个参数、122个方法标准的检测能力，从环境保护、仪器设备、人员技能等方面进行了现场验证和审核。

评审组认为，该中心组织机构设置合理，管理体系运行有效，人员、场所环境、设施设备等资源配置均符合RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》及相关检测标准要求，一致同意通过国家资质认定现场评审。

来源：壹集微



西安三星高端存储芯片二期第一阶段项目产品下线上市

据西安新闻网报道，3月10日，三星（中国）半导体有限公司举行三星高端存储芯片二期第一阶段项目产品下线上市仪式。

据悉，三星高端存储芯片二期第一阶段项目投资约70亿美元，目前已具备量产能力，预计今年8月实现量产。而此次下线上市的正三星高端存储芯片二期第一阶段项目的首批产品；二期第二阶段项目，投资约60亿美元，于2019年12月25日正式启动，预计2021年上半年实现量产。



据去年报道，三星高端存储芯片二期项目第一阶段预计2020年3月竣工投产；第二阶段2021年下半年竣工。从目前消息看，该项目进展顺利。

此外，据新华社3月初报道，西安高新区的三星半导体存储芯片一期项目一、二月份实现满产生产，二期项目正按计划推进。三星（中国）半导体有限公司副总裁陆基表示，受疫情影响，2月份公司曾出现物流不畅、原材料供应乏力、人力不足等问题，但在陕西省、西安市政府和企业合作努力下，公司一期项目一、二月份保持着每月生产13万片存储芯片的满产成绩。

来源：壹集微

获准入境！三星200名员工乘中国包机抵西安芯片厂

据路透社报道，三星电子周三表示，中国政府已允许该公司旗下200名员工入境，支持其西安NAND芯片厂的扩建工作。

近期，中韩外交部举行副部长级会议，并决定为两国企业开通“快速通道”，允许商务以及技术人员通行，以确保全球供应链的正常运行。

正因如此，三星位于西安的第二座内存厂迎来了这一好消息。

三星电子发言人表示，周三，一架特許的中国国航飞机搭载了三星电子的百余名员工。该发言人进一步指出，公司员工抵达西安后将遵循当地政府政策。

与此同时，韩国驻西安总领事馆的一名干事告诉路透社，“三星员工不会被免除陕西省14天的检疫规定。他们抵达后将在机场接受冠状病毒检测，并将被送往中国当局指定的酒店。”

来源：壹集微

郝跃院士获2019年度陕西省最高科学技术奖



3月11日，在陕西省省长刘国中主持召开省政府第六次常务会议上，郝跃院士被授予2019年度陕西省最高科学技术奖。

郝跃院士是国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)“核心电子器件、高端通用芯片和基础软件产品”科技重大专项实施专家组组长，国务院第七届全国学科评议组电子科学与技术一级学科召集人，国家自然科学基金委员会信息科学部主任，高等院校电子信息类专业教学指导委员会主任委员，教育部科技委员会委员，国家重大基础研究计划(973计划)项目首席科学家，陕西省科学技术协会副主席，微电子技术领域的重要专家。他是第九、第十、第十三届全国政协委员和第十一届全国人大代表。

2010年11月当选中国科学院院士。

郝跃院士长期从事新型宽禁带半导体材料和器件、微纳半导体器件与高可靠集成电路等方面的科学研究与人才培养。在氮化镓碳化硅第三代(宽禁带)半导体功能材料和器件、半导体短波光电子材料与器件研究和推广、微纳CMOS器件可靠性与失效机理研究等方面取得了系统的创新成果。

来源: 爱集微

“西安·国家新一代人工智能创新发展试验区”启动建设大会举行

科技使命，AI赋能。4月9日上午，“西安·国家新一代人工智能创新发展试验区”启动建设大会在高新区举行。省委常委、市委书记王浩，副省长赵刚出席大会并揭牌。会上签约11个项目，累计金额37.2亿元。

本次大会以线上和线下结合的形式举行，科技部战略规划司副司长张旭，雷灵英得主，中科院院士魏翔智，创新工场创始人李开复，科大讯飞董事长刘庆峰等发来视频寄语。省政府副秘书长兰建文，省科技厅厅长赵蔚，市领导钟洪江、杨晓东、马科等参加。

会上，魏翔智团队将他们在西安研制的第一款人工智能芯片“启明910”芯片样品捐赠给西安市。与会领导为西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学、长安大学、华为西安研究所、西安交叉信息核心技术研究院等6家单位授予“西安新一代人工智能开放创新平台”。

市委、市政府将人工智能列入“6+5+6+1”产业体系，加强政策和资金支持，推动产学研一体化联动，目前拥有省级以上研发平台49个，关联企业150余家。涵盖了人工智能主要产业领域。西安将以获批建设“国家新一代人工智能创新发展试验区”为契机，充分发挥先行先试优势，大力推进基础理论研究，关键技术攻关，应用场景建设，专业人才培养，充分发挥试验区平台聚合效应，促进人工智能同经济社会深度融合。

市属相关部门主要负责同志，人工智能领域企业家和专家学者等参加。

来源: 西安发布



卫光科技六时线二期高端功率器件项目首台重点工艺设备移入

近日，西安卫光科技有限公司(卫光科技)六时线二期高端功率器件项目首台重点工艺设备超薄晶圆减薄机DFG8540移入微晶微电子有限公司生产线。该设备是为典型高功率IGBT器件超薄晶圆减薄工艺所需，主要用于6英寸硅片的网络减薄工艺，可将硅片减薄至85um，同时可保证硅片的平整度。设备的引入将在推进微晶微新产品工艺研发、新品研制等方面发挥引领作用。

截至目前，六时线二期项目中已有2台辅助设备奥林巴斯显微镜移入生产线。本次重点工艺设备减薄机DFG8540的顺利移入，具有里程碑意义，同时标志着六时线二期项目的全面有序开展。微晶微电子有限公司全体员工，众志成城，攻坚克难，继续抢抓窗口期，为确保持续平衡项目、二期项目的顺利完成，为公司产品高质量发展进一步拓展平台奠定基础，赢得主动。

西安卫光科技有限公司(国营第八七七厂)，成立于2007年元月，由原西安卫光电子厂整体改制而来，隶属于陕西电子信息集团。公司位于西安高新产业开发区电子工业园，占地面积14.7万平方米，现有员工1000余人，是我国低损耗大功率半导体器件重点企业 and 军用元器件研制、生产重点企业，也是我国最早生产半导体器件的专业企业之一。

来源: 卫光科技

陕西电信携手华为试点全球首个200MHz 5G LampSite

打造5G室内用户极致体验

近日，陕西电信携手华为在西安完成了全球首个5G LampSite 200MHz 4T4R室内数字系统试点，旨在验证电信室内5G高频共建共享方案。共享模式下，电信5G用户下行峰值速率达到1.29Gbps，联通5G用户下行峰值速率达到1.26Gbps，完全满足共建共享设计要求，并启动5G载波聚合功能后，电信5G单用户下行峰值速率达2.2Gbps，进一步提升用户体验。

2019年9月中国电信和中国联通宣布合作共建共享5G网络，实现5G网络高效覆盖，快速形成5G服务能力，给用户带来更好的5G网络体验。同时提升网络和投资运营效率。作为陕西电信主要的室内5G共建共享方案，5G LampSite 200MHz可同时支持多频，对新建室内场景可实现4G/5G一体化部署。本次试点得到了陕西联通大力支持，电信联通双方在测试过程中密切配合，试点的成功，标志着两家运营商共建共享的合作又迈出了实质性的一步，将为日后大规模共建共享室内数字化网络提供宝贵的规划和工程参考依据。

为了进一步提升共建共享资源的优势，本次试点还验证了5G载波聚合(CA)功能，让用户可以同时享受200MHz带宽带来的前所未有的速率体验。现场进行的CA测试，下行峰值速率达2.2Gbps，让用户享受超高速下载率极致体验。

来源: C114通信网



西安电子科技大学联合主办 2020年先进集成电路设计自动化国际研讨会



1月9日-10日，2020年先进集成电路设计自动化国际研讨会在西安成功举办。本次会议由西安电子科技大学与国微集团深圳有限公司联合主办，西安电子科技大学微电子学院、西电国微EDA研究院承办。

中国科学院院士郝跃、亚美尼亚皇家工程院院士 Vazgen Melikyan、法国国家科学研究中心主任研究员 Aida Todri-Sarria、巴西南大河州联邦大学教授 Ricardo Reis、新加坡南洋理工大学助理教授 Mohamed Mostafa Sabry Aly、巴西南大河州联邦大学博士后研究员 Momo Metzler Carolina、国微集团副总

黄贵勇、西安电子科技大学微电子学院院长张玉明，以及来自清华大学、北京大学、南洋理工大学、香港中文大学等6个国家及地区的40余名专家学者参加了此次研讨会。开幕式由西安电子科技大学国微EDA研究院副院长唐海定主持。

张玉明在致辞中表示，开展EDA领域的国际学术交流，对共同形成创新活力旺盛的科技研发，共同加速相关技术和产业的多方面发展，具有重要意义。西安电子科技大学是国内最早开展微电子专业人才培养和科学研究的单位之一，是国微电子人才培养和高水平科研创新的重要基地。希望以本次研讨会为契机，促进前沿研究成果的分享，加强学术沟通，深入研讨，为学术文化创新、协同共进注入新的活力。

开幕式上，郝跃院士为海外学术骨干 Vazgen Melikyan 教授等四人颁发了聘书。

本届研讨会邀请了EDA领域国内外知名学者，来自法国、新加坡、巴西等6个国家及地区的14名专家学者围绕先进集成电路设计自动化理论与实践各方面做了特邀报告和研讨。特邀专家包括：Vazgen Melikyan 教授、Ricardo Reis 教授、Aida Todri-Sarria 研究员、Mohamed M. Sabry Aly 教授、Momo Metzler Carolina 研究员、北京大学罗国杰教授、清华大学喻文俊教授、福州大学陈建利教授、南方科技大学陈全教授、北京航空航天大学成元民教授、香港中文大学余备教授、西安电子科技大学吕红亮教授等海内外专家学者。

据悉，2020年先进集成电路设计自动化国际研讨会举办，旨在建立国际国内集成电路设计自动化领域交流合作平台，以科技创新引领，推进产学研深度融合。此次会议主要探讨先进工艺制程下集成电路设计自动化面临的挑战和机遇问题，以及交流EDA的人才培养合作。

来源：未来网高校

我市复产水平明显提升 工业生产加快恢复

一季度，我市全力保障企业复工复产，取得了阶段性成果，企业复工复产水平不断提升。尤其是3月份以来，工业生产水平明显恢复，全市工业经济发展积极向上。

企业生产恢复加快 总体降幅收窄

工业生产降幅收窄。一季度，全市规模以上工业增加值下降2.1%，降幅较1-2月收窄1.2个百分点，降幅低于全国。全省6.3和0.9个百分点，在省内地市中排第4位；完成工业总产值1230.36亿元，下降6.9%，降幅较1-2月收窄6.1个百分点。

大、中、小型企业产值降幅均收窄。百亿元企业总体增长；从单位规模看，全市大、中、小型企业产值降幅均有所收窄。一季度，全市规模以上大型企业完成产值733.79亿元，占全市59.6%，同比下降1.3%，降幅低于全市7.6个百分点；中型企业产值228.88亿元，占全市18.6%，产值下降6.0%，降幅较1-2月收窄13.8个百分点；小型企业产值267.69亿元，占全市21.8%，产值下降26.3%，降幅较1-2月收窄11.1个百分点。综上，疫情对大中小型企冲击较1-2月减小。

从重点企业看，全市9家百亿元企业产值总体增长，呈“四升五降”态势。一季度，9家百亿元企业合计完成工业总产值489.79亿元，占全市41.5%；增长3.3%，增速高于全市12.2个百分点，拉动全市产值增长1.2个百分点。

七成多行业产值增速回升或降幅收窄 汽车医药食品制造业生产水平提高

一季度，随着企业复工复产水平提升，全市36个行业中26个行业产值增速较1-2月回升或降幅收窄，占全部大类行业的72.2%。其中，汽车制造业产值下降34.6%，降幅较1-2月收窄11.8个百分点；电器机械和器材制造业下降1.8%，降幅收窄16.9个百分点；医药制造业增速由1-2月的下降6.4%变为增长3.1%，由负转正，回升9.5个百分点；化学原料和化学制品业下降6.4%，降幅收窄13.6个百分点；农副食品加工业下降7.3%，降幅收窄7.3个百分点。

高新技术和战略性新兴产业较快增长 有力支撑全市生产恢复

一季度，全市规模以上工业战略性新兴产业完成产值600.01亿元，占全市48.8%；增长11.1%，增速高于全市20.0个百分点；拉动全市产值增长14.6个百分点。规模以上高技术制造业完成产值443.00亿元，占全市36.0%；增长28.4%，高于全市37.3个百分点；拉动全市产值增长8.7个百分点。其中，电子及通信设备制造业产值占全市28.1%，增长42.8%，拉动全市产值增长7.7个百分点。逆势而上，带动强劲。战略性新兴产业，高技术制造业产值增速增长，对全市工业生产恢复向好形成有力支撑。

新兴产业持续较快增长 发展势头向好

一季度，全市主要新兴产业保持较快增长态势。其中，集成电路增长6.3%，新能源车增长92.4%，中成药增长29.8%，单晶硅增长126.5%，多晶硅增长194.3%，锂离子电池增长22.3%，光纤增长16.4%，光伏增长0.5%，3D打印增长50.0%，新兴产业发展势头较好。|

来源：西安市发改委

一季报密集出炉 多家半导体厂商业绩报喜

近期，已陆续有半导体企业发布一季度业绩预告，从目前披露的情况看来，已有多家厂商一季报业绩报喜，包括紫光国微、韦尔股份、华润微、安集科技等几家企业的净利润均较上年同期实现了较大幅度的增长。

紫光国微：净利润同比增长183.41%

4月23日，紫光国微一季报新解出报，报告显示，今年第一季度紫光国微实现营业收入0.46亿元，同比减少3.47%，本报告期起不再合并西安紫光国芯收入；实现归属于上市公司股东的净利润1.90亿元，同比增长183.41%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润为1.76亿元，同比增长366.67%。

此外，紫光国微还对今年上半年业绩作出预告，预计归属于上市公司股东的净利润介于2.70亿元-3.28亿元，变动幅度介于40.0%-70.0%，对于业绩变动原因，紫光国微表示公司集成电路设计业务经营规模和收益均保持了快速增长，特种集成电路业务继续贡献稳定利润。

韦尔股份：净利润同比增长800.03%

4月23日，韦尔股份也发布了其一季度业绩，报告显示，今年一季度韦尔股份实现营业收入8.17亿元，同比增长44.21%；实现归属于上市公司股东的净利润4.45亿元，同比增长800.03%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润0.436亿元，同比增长1530.80%。

韦尔股份2019年完成了对北京豪威及思比科的收购，主营业务增加了在CMOS图像传感器领域的布局。随着北京豪威及思比科并表，韦尔股份的盈利水平和综合实力得到明显提升，业界认为其第一季度营收和净利润增长很大程度由于CMOS图像传感器业务报喜。

华润微：净利润同比增长450.35%

4月23日，华润微发布其一季度业绩，报告显示，今年一季度华润微实现营业收入13.82亿元，同比增长16.53%；实现归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，同比增长450.35%；归属于上市公司股东的扣非的净利润9004.97万元，同比增长292.16%。

华润微表示，2020年一季度公司受疫情影响较小，经营状况保持稳定，整体业绩好于去年同期，营业收入同比实现增长以及归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅增长近1亿元，主要系营业收入增长、毛利率提升、产品获利能力好于去年同期所致。

安集科技：净利润同比增长426.00%

4月21日，安集科技披露其一季度业绩，报告显示，今年一季度安集科技实现营业收入19633.81万元，同比增长64.00%；实现归属于上市公司股东的净利润2355.64万元，同比增长426.00%；实现归属于上市公司股东的扣非的净利润2273.49万元，同比增长482.72%。

安集科技在报告中表示，一季度营收增长主要系客户用量上升所致。据了解，安集科技目前的主要产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂，主要应用于集成电路制造和先进封装领域，其客户包括中芯国际、台积电、长江存储、日月光、长电科技等。

其他及业绩预告

除了上述几家净利润同比增幅较大外，近日上海新阳、中颖电子、赛富斯等企业也发布了自家一季度业绩，归属于上市公司股东的净利润亦不同程度实现了增长，上海新阳同比增长59.45%，中颖电子同比增长20.77%，赛富斯同比增长23.76%等。

除了已发布的一季报业绩外，前段时间也有不少企业发布了一季度业绩预告，其中亦有多家企业均业绩预告颇为亮丽。

如国内封装大厂华天科技，其预计一季度归属于上市公司股东的净利润85000万元-70000万元，比上年同期增长200.16%-320.22%。华天科技表示，一季度集成电路市场景气度较上年同期大幅提升，公司订单饱满，但由于受疫情影响公司主要生产基地春节后复工时间较计划均大延迟后，对公司一季度业绩造成较大影响。综上，公司一季度归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期有较大增幅增长。

设计厂商北京君正预计其一季度归属于上市公司股东的净利润约1220.32万元-1292.15万元，比上年同期增长397.56%-426.85%。北京君正称，报告期内公司智能视频芯片销售收入同比增长，但微处理器芯片销售收入同比有所下降，公司总体营业收入较去年同期略有增长。同时，公司收到的政府补助、理财收益较较去年同期也有所增长。

此外，富瀚微、雅克科技、南大光电、圣邦股份、富满电子等厂商亦预计其一季度业绩将实现较大幅度增长。值得一提的是，4月7日国内晶圆代工大厂中芯国际宣布上调其一季度业绩指引，将其一季度收入增长指引由原先的

0%-2%上调为6%-8%，毛利率指引由原先的21%-23%上调为25%-27%，理由为看见产品需求的增长及产品组合的优化都超过了预期。

小结

今年以来，由于新冠疫情爆发导致节后复工复产后，物流受限等，半导体企业亦受到不同程度的影响，但收益于去年下半年半导体行业复苏以及前年订单饱满等，从上述多家企业的一季报及预告来看，一季度半导体企业似乎表现还不错。

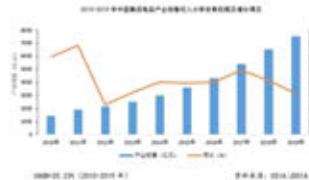
不过，上文只是选择了业绩预告较好的企业作例，一季报中亦有部分企业业绩下滑或亏损，且目前一季报仍未披露完毕，不少企业尚未发布一季报，一季度半导体企业的业绩尚不能一概而论。此外，一季报更多反映的是年前情况，随着疫情持续蔓延，业界更为担忧下半年的产业情况。

备注：以上内容为集邦咨询TrendForce原创，禁止转载、摘编、复制及链接等使用，如转载敬请在后台留言取得联系。

来源：全球半导体观察

2019年中国集成电路产业情况

据中国半导体行业协会统计公布：2019年中国集成电路产业销售收入为7562.3亿元，同比增长15.80%，其中：设计业销售收入为3063.5亿元，同比增长21.6%，占总值40.5%；晶圆制造业销售收入为2149.1亿元，同比增长18.20%，占总值的28.40%；封装业销售收入为2349.7亿元，同比增长7.10%，占总值的31.1%，都取得了较好的业绩。



据海关统计，2019年中国集成电路进出口总额为4071.3亿美元，同比增长2.90%，其中：进口集成电路金额为3055.5亿美元，同比下降2.1%，出口额为1015.8亿美元，同比增长20%，实现集成电路出口额增速反超进口额相对值22.1个百分点。但进出口逆差仍为2039.7亿美元，同比下降10.3%。2019年中国集成电路进出口量为6638.3亿块，同比增长4.7%，其中：进口集成电路4451.3亿块，同比增长6.60%；出口集成电路2187亿块，同比增长0.7%，进出口量逆差为

2264.3亿块，同比下降12.9%。

据工信部近日公布：2019年中国集成电路产品产量为1851.6亿块，同比增长7.9%，其中：2019年12月份中国集成电路产品产量为208.8亿块，同比增长30.00%，环比增长20.80%；2019年四季度中国集成电路产品产量为535.0亿块，同比增长24.1%，环比增长9.6%，创历史新高水平。

据WSTS统计情况，2019年世界半导体市场销售额为4121亿美元，较2018年同比下降12.1%，较2017年的峰值回落33.7个百分点，是近十多年来的谷底。

来源：集成电路网

长江存储推出128层QLC闪存，单颗容量达1.33Tb

2020年4月13日，中国武汉，长江存储科技有限责任公司宣布其128层QLC 3D NAND 闪存（型号：X2-6070）研发成功，并在多家控制器厂商SSD等终端存储产品上通过验证。作为业内首款128层QLC规格的3D NAND闪存，长江存储X2-6070拥有业内已知型号产品中最高单位面积存储密度、最高I/O传输速度和最高单颗NAND 闪存芯片容量。此次同时发布的还有128层512Gb TLC（3 bit/cell）规格闪存芯片（型号：X2-9060），以满足不同应用场景的需求。



▲ 长江存储 X2-6070 128L QLC 1.33Tb 3D NAND

长江存储市场与销售高级副总裁龚英（Grace）表示：“作为闪存行业的新人，长江存储用短短3年时间实现了从32层到96层再到128层的跨越。这就是数千长存人汗水的凝聚，也是全球产业链上下游通力协作的成果。随着Xtacking 2.0时代的到来，长江存储有信心、有能力开创一个崭新的商业生态，让我们的合作伙伴可以充分发挥各自优势，达到互利共赢。”

Xtacking 2.0 进一步释放闪存潜能
得益于Xtacking® 架构对3D NAND控制电路和存储单元的优化，长江存储64层TLC产品在存储密度、I/O性能及可靠性上都有不俗表现。上市之后广受好评。

在长江存储128层系列产品中，Xtacking®已全面升级至2.0，进一步释放3D NAND闪存潜能。在I/O读写性能方面，X2-6070及X2-9060均可在1.2V Vccq电压下实现1.6Gbps（Gigabits/s 千兆位/秒）的数据传输速率，为业界最高。由于外围电路和存储单元分别采用独立的制造工艺，CMOS电路可采用更先进的制程，同时在芯片面积没有增加的前提下Xtacking®2.0还为3D NAND带来更好的扩展性。未来，长江存储将与合作伙伴携手，构建定制化NAND商业生态，共同推动产业繁荣发展。

长江存储通过对技术创新的持续投入，已成功研发128层两款产品，并确立了在存储行业的技术创新领导地位。凭借1.6Gbps高速读写性能和1.33Tb高容量，长江存储通过X2-6070再次向业界证明了Xtacking®架构的前瞻性和成熟度。为今后3D NAND行业发展探索出一条切实可行的路径。龚英（Grace）强调：“我们相信，长江存储128层系列产品将会为合作伙伴带来更大的价值，具有广阔的市场应用前景。其中，128层QLC版本将率先应用于消费级SSD，并逐步进入企业级服务器、数据中心等领域，以满足未来5G、AI时代多元化数据存储需求。”

X2-6070充分发挥QLC技术特点

QLC是继TLC（3 bit/cell）后3D NAND新的技术形态，具有大容量、高密度等特点，适合于读取密集型应用。每颗X2-6070 QLC闪存芯片拥有128层三维堆栈，共有超过3.665亿个有效的电荷俘获型（Charge-Trap）存储单元。每个存储单元可存储4位（bit）的数据，共提供1.33Tb的存储容量。如果将记录数据的0或1比喻成数字世界的小“人”，一颗长江存储128层QLC芯片相当于提供3.665亿个房间，每个房间住2“人”，共可容纳的14,660亿“人”居住。是上一代64层单颗芯片容量的5.33倍。

闪存和SSD领域知名市场研究公司Forward Insights创始人兼首席分析师Gregory Wong认为：“QLC降低了NAND闪存单位字节（Byte）的成本，更适合作为大容量存储介质。随着主流消费级SSD容量迈入512GB及以上，QLC SSD未来市场增量将非常可观。”Gregory同时表示：“与传统HDD相比，QLC SSD更具性能优势。在企业级领域，QLC SSD将为服务器和数据中心带来更低的延迟，使其更适用于AI计算、机器学习、实时分析和大数据中的读取密集型应用。在消费类领域，QLC将率先在大容量U盘、闪存卡和SSD中普及。”

注：

1.对比范围：截至2020年4月13日，全球已公开发布的3D NAND Flash存储芯片。

2.长江存储、YMTC、YM图形徽标和Xtacking是长江存储科技有限责任公司或其分子公司在美国和其他国家地区的商标。

来源：长江存储科技有限责任公司

蓝牙市场最新预测：至2024年，全球蓝牙设备总出货量将达到62亿

蓝牙技术联盟全球成员公司将突破36,000家，蓝牙社区通过持续增长动能布局全球市场

2020年4月15日，蓝牙技术联盟（Bluetooth Special Interest Group，简称SIG）今日发布了《2020年蓝牙市场最新资讯》。随着蓝牙技术正不断从个人通信解决方案扩展为面向商业和工业级应用的互连引擎，此份报告将揭示未来五年蓝牙技术及市场的主要趋势和预测。

从无线音频传输和可穿戴设备，到位置服务及设备网络解决方案，蓝牙技术联盟成员公司持续满足普通消费者、商业及工业市场的需求。《2020年蓝牙市场最新资讯》公布了蓝牙技术联盟成员社区的发展与前景，以及蓝牙技术的发展轨迹，其中包括各主要蓝牙解决方案领域的趋势、统计数据及预测。

音频传输——蓝牙技术免去了连接线的烦扰，为音频领域带来了使用体验的变革，并彻底地改变了人们通过多媒体交流的方式。凭借低功耗音频（LE Audio）的推出，蓝牙技术将再次改变体验音频的方式，并让人们以前所未有的方式与世界相联。预计至2024年，蓝牙音频传输设备年出货量将达到15亿，较2019年增长40%。

数据传输——从家用电器和健身追踪器到健康传感器和医疗创新，蓝牙技术连接着数十亿台日常设备，并推动了无数的发明创造。至2024年，蓝牙数据传输设备年出货量将达到15亿。

位置服务——蓝牙是开发者的首选技术，可助力创建用于地标信息和物品追踪的接近度解决方案，以及用于资产跟踪和导航的定位系统。至2024年，蓝牙位置服务设备年出货量将达到5.38亿，较2019年增长4倍。

设备网络——随着经认证的蓝牙mesh相关产品数量每六个月增长一倍，以及家居自动化和商业照明领域创新企业的迅速采用，蓝牙mesh已有力证明了其在创建控制、监测及自动化系统方面的适用性，使成百上千台设备能够进行可靠、安全地通信。至2024年，蓝牙设备网络设备年出货量将达到8.92亿。

报告指出传统蓝牙市场主要趋势包括：

音频及娱乐——通过蓝牙音频的变革，未来蓝牙音频



市场将呈现巨幅的增长态势，预计仅在2020年内，蓝牙音频及娱乐设备出货量就将达到15亿台。

汽车——无钥匙开锁系统、轮胎压力监测和状态警报等解决方案，成为近期在汽车领域的热门及创新应用。这些用例都在创造并提升了无线传感器的需求，预计未来每辆汽车中将加装4至6个蓝牙传感器。

手机、平板电脑及个人电脑——至2024年，蓝牙位置服务将覆盖超过10亿部手机，用于室内导航、寻物、地标信息等解决方案，成为智能手机体验中不可或缺的一部分。

互连设备——随着位置服务对日常生活的影响力日益提升，用于寻物、人员及宠物追踪的标签使用也日益增长。至2024年，用于定位和位置服务的标签年出货量将增长3.4倍。

蓝牙技术联盟首席执行官Mark Power表示：“每一年，蓝牙技术联盟成员社区都致力于开展创新，助力塑造全新市场趋势。凭借全球成员公司的持续努力，蓝牙技术才能在如今的智能楼宇、智能家居和智慧城市市场发挥重要作用。低功耗音频的推出，加速了蓝牙音频及娱乐解决方案的发展，进一步印证了蓝牙技术对市场趋势发展的显著影响力。”

《2020年蓝牙市场最新资讯》报告也提供了蓝牙在新兴市场的预测和数据，包括智能家居、智慧城市、智能工业和智能楼宇领域的预期增长。

来源：大半导体产业网

魏少军：疫情之后，我国半导体产业发展的关键在哪里？

假如其新的新冠肺炎疫情席卷全球，半导体供应链不可避免地受到重创。那么疫情对国内半导体产业有何影响，发展关键在哪里？疫情中的芯片企业如何抓住发展机遇？以下是清华大学微电子学研究所所长魏少军教授4月28日做客央视财经《战“疫”后新机遇》的解读。

新冠疫情对国内半导体产业影响相对有限

面对本次新冠肺炎疫情对集成电路产业现状的影响，我们要从客观、辩证、对于未来可能出现的产业变化，我们要有所思考，有所准备，厚积薄发。对于未来的发展，应该早做准备，要有所作为。应该说新冠肺炎疫情对国内半导体产业的影响从整体来说是有限的，而且是可控的。这里展露了一些现实情况，第一就是肺炎发生的时机刚好是春节前后，大部分产业都放假，有些工厂本来就要停工停产，因此整体对产业的影响不是太大；第二，有些可能是不能停工的，比如制造厂它要24小时的进行不间断的生产，半导体的生产，环境非常苛刻，因为我们工作在纳微米的情况下，一般的供应链是在微米级，所以我们工厂的过滤系统其实把病毒全过滤掉了，所以你在工厂里工作是不会受到这种传染的，比如感染的风险是相对比较低的；第三是我们的市场非常好，去年全球半导体出现了一次回调，导致了库存的降低，去年四季度开始，全球半导体都开始往上走，要把库存补充上去，所以我們一季度的订单非常好的，基本上工厂是开工很足，因此产业并没有受到太多影响。

从国家统计局最近发布的第一季度国民经济统计来看，第一季度GDP是下降了6.8%，而集成电路实际上是增长了13.1%，维持两位数的增长。因此疫情对我们直接影响不大，但对我们的间接影响还是非常大的，而且这种影响应该说不是很短暂，从制造、设计、封装这三业来看的话，封装业受到的影响比较大。由于芯片设计主要靠我们工程师的大脑工作，平时的工作也是在计算机上，所以虽然疫情来了，但是我们可以通过保证知识和技术安全的情况下，通过网络办公，通过网络上课，实际上是可以有效的抵消疫情的影响。而封装业就具有一定的劳动密集型的这种属性，因为大量的设备要靠人工操作，在疫情期间不可以把个人全部聚集起来，造成的影响相对大一些，但由于中国整个的疫情控制得比较好，所以我们这个问题已经相对缓和了。

市场的收缩，将导致对进口芯片的需求骤减

从国际情况来看，我们没有预见到疫情会发展到这种程度。所以国际上的疫情反过来对我们国内的半导体的影响，可能两个层面会逐渐的显现出来。面对未来的发展我觉得总体有两个判断，第一个判断，是国内的半导体产业今年还会持续扩张，第二个判断，由于疫情影响，前面我们曾经连续五年六七年比较多的芯片进口，今年可能会受到压

缩。

第一个判断国内产业为什么可以扩张？因为国外的疫情造成的这种影响，现在看起来短期内不会结束，因此国际上的物流的影响会间接的导致我们国内出现供应不足的情况，结果会导致我们国内的产业又恢复了，原来用国外的器件，现在就在有可能取用国内的器件，原来用国外的半导体产品，现在改用国内半导体产品，因此国内的产品反而会得到一定的发展空间，对国内的半导体产业是好事了。

但是，也不要指望说这个情况会对我们的产业提升起多大的作用。因为我们特别的是尽量出现我们国内的配套，内部的供应链的这种需求增加，但是我们整个产业的增长也可以继续维持扩张，但是不会像前几年那么快了。前几年我们一直在两位数，去年是平均在16%左右，在前几年大概平均在20%上下，那么今年我们觉得大概率事件应该是在一位数增长，也可能在零附近波动，维持零偏上一点。这个不仅仅是在我们国内的情况，在国际上的半导体大概看起来比我们更不乐观，因为全球半导体去年是负12%的衰退，今年本来还是希望它能有一定的增长，现在看起来正增长，由于疫情的影响会出现一些不利的因素。

第二个判断是芯片进口量会降低，前几年我们的进口量一直保持在2000多亿美元到3000亿美元，2018、2019年连续达到3000亿美元以上，今年就有可能会降下来，原因也很简单，因为中国实际上并没有消耗那么多的芯片，我们进口的3000多亿美元，其实我们只用了半，还有1000多亿美元就到整机当中又出口了，所以我们属于出口的经济，由于我们的产品出口欧美，总体来看，用的更多的是进口的芯片来供应国内市场。受疫情影响，欧美市场自身受到萎缩，导致市场需求的下降，这必然会影响到我们对进口芯片的需求放缓。

半导体是全球化程度最高的产业

我认为未来几年全球供应链，半导体的供应链结构调整，这个规模是巨大的，或者说是一个大事件，所以自然全面看我就认为它不大可能，因为全面看的话比较大，而且短期内也靠不了，小部分的调整是有可能的，那么如果调整的话，我觉得他可能有两个方面来思考，第一是否有利于利润的最大化？

我们知全球它不是一个政治因素决定的，它是一个经济因素决定的。为什么要全球化？开始的时候是要把生产搬到那些成本比较低的地方去，使得我们的生产成本降低，最终是我的利润能够提升，第二就是把我的工厂搬到离消

费者最近的地方去，降低物流成本，管理成本和市场成本，来争取利润最大化，这是全球化当中最重要的驱动力。另外一个要素必然是有利于市场的拓展，这要看各个地方的经济发展情况，毫无疑问，中国是全世界经济增长最快的，也带来发展速度比较好的，这些国家虽然它慢慢的增长开始从两位变成一位数，但是在这么大体量情况下，100万亿人民币的GDP当中，你有百分之4-5%，你可能比一些其他国家的10%要大很多。

中国的经济发展将成为未来集成电路产业发展的一个关键性决定因素，合理成本构成是我们经济中非常重要的的一环，有些企业想走出去发展，但你要想想，你是不是有好的成本构成？你是不是还能在中国市场上占有如此好的先机，如此好的优惠条件，对于投资者来说，一定会算这笔账的。另外一点就是你是否合理的成本构成，你可以搬到我去，我这一次性把成本搬到去了，但是你想回去以后，还要考虑后面的物流成本、原材料成本、管理成本、运输成本、销售成本等方面的因素。

另外，科技进步，特别是高科技产业很大的一个因素，还有人才的问题，人力资本你不是足够，使得中国在过去几十年的改革开放过程当中，应该讲我们尽管有很多自己不平衡的地方，但我们在物流方面，生产能力方面，人力成本方面，市场环境方面还是很有综合优势的。我相信他大部分是说而已，即便发生这种全球供应链的调整，也不是一朝一夕的事情，因为我们之所以成为现在这个样子，也是经过了几十年的努力，我不相信这个事情可以发生一夜变化，所有企业想跑到美国去，全搬走了，全世界恐怕也要经济停顿了，不是停了一年而是好几年了，这并不意味我们没有任何，没有毛病，没有问题，我们是碰到很多的问题，这是挑战，这是考验。

我们供应链的供应链在发生变化，如果你不应对的话，你就可以处于被动的状况，如果你能够提前做好准备，我们就可以取得更多先机，当然这个过程也不是一个孤立的事情，它应该是一个全球合作加强和多赢的局面，面对我们未来可能出现的问题，我们到底应该采取什么样的策略，我们的思路应该是什么呢，我认为可能还是要通过加强推进市场化配置资源的这样一个思路来进行，半导体是个全球化程度最高的产业，相比其他产业来说，半导体产业的全球化是最厉害的，举个例子，我们知道美国半导体大国的，美国的半导体产业占据了全球市场的48%-50%，但是你知道看美国海关统计，它出口的半导体芯片，你也是发货很少，大概1%左右吧，美国公司的半导体的产品是以什么方式卖到全世界去？实际上它通过产品的转移，他已经实现了所谓原产地的全球化，比如美国高通设计的手机芯片，他设计完了在中国台湾加工，加工完了的芯片送到马来西亚去封装，再卖到中国去，那这个产品算谁的呀？算马来西亚的产品，如果这个产品从台湾直接运到中国大港，封装了以后，又卖到美国去了，算谁的产品？算中国的产品，算中国出口到美国的产品，这

是一个全球化过程当中非常重要的一部分，这种原产地的认定早在十多二十年前，你就已经实现了全球化。

那么为什么会发生这种状况？是因为利益最大化的共同诉求，使得我们想方设法把我们的产业，把我们的产品的转移到有可能降低我们最终的消费成本和制造成本的那个地方去，所以我一直说全球化不是一个政治产品，是一个利益驱动的产品，就是从从这个角度去讲，半导体应该说是非常典型，而且是全球化一定是谁最便宜的一个条件，如果从靠近消费者来说，应该是半导体产业向着用户所在地集中，这也是个大趋势。

为什么有很多厂都搬到中国来？是因为中国是他最大的客户，其实如果去认真看一看，其实我们可以看到很多非常有趣的现象，美国有些半导体企业，他10%的产品是卖给中国的，有相当一部分的半导体企业，包括一些很大的半导体企业，他们利润当中有50%来自中国，他不仅仅是为了中国的劳动力便宜，其实我们现在的劳动力不便宜了，而是更因为 he 靠近客户，更容易拿到更大的市场份额。

半导体产业和国民经济的增长实际上是有很大的相关性，就是它和相关系数非常高，2010年国际上有人做过统计，大概是30%的概率GDP跟半导体产值是相关的，这就意味着什么？中国的经济如果不出问题，全球半导体开中国的概率被很高，中国经济的发展决定了全球大概很难离开中国，而且不是今天离开中国，恐怕未来20年都很难离开中国。

要完善半导体产业生态

过去几年我们虽然取得了很好的成绩，但并不意味着我们整个产业生态环境已经很好，相反我们的产业生态当中的，有很多东西还是有缺陷，还有影响，所以从这个意义上来看的话，我们完善产业生态是非常重要的一个任务，而供应链就是产业生态当中非常重要的一个环节，中国半导体产业发展的根本动力是市场，这一点必须强调，市场决定了我们的产业发展，而政府的作用恰恰是在建设和完善市场，你看这个是一个两者相相结合这样一种关系。

中国半导体产业发展的要素并不完全齐备，有强的，有弱的，有短板，个别地方还有缺陷，比如我们的半导体材料就是短板，我们的设备就是短板，当然我们还有到我们的制造，对现在为止进步很快，但总体而言我们最先进得比这还有差距，在这种情况下，我们应该怎么去改善？我觉得有两个非常重要的关键，第一个就是产品创新，第二个就是生态环境，创新驱动产业。

产品是半导体产业安身立命的根本，尽管产业生态发生了变化，产业模式也出现了多样化，但要素围绕产品发展，这是趋势，没有产品，再好的制造能力也是枉然，现在同样在强调创新，围绕产品创新，突破芯片设计、制造、封装、装备和材料。

魏少军 中芯集成CEO

大基金二期首个投资项目完成签署：45亿到账紫光展锐

国家集成电路产业投资基金二期（大基金二期）首个投资项目紫光展锐项目已经完成签署。

4月28日，国家大基金二期和上海国盛集团共同向紫光展锐注资45亿元，日前已完成签署，资金已经到账。

之前，正在冲刺科创板的紫光展锐即将拿下新一轮注资，投资方分别是国家集成电路产业投资基金（国家大基金）二期和上海国盛，两者各投22.5亿元。

由于新冠疫情影响，大基金二期投资节奏有点放缓，但由于紫光展锐正在冲刺科创板，大基金在关键时刻给予紫光展锐支持。

据了解，紫光展锐已启动IPO，内部股权激励已展开，部分员工已签署股权激励协议。根据紫光展锐上市计划，预计今年6月30日前完成科创板IPO申报。

2019年5月，紫光展锐宣布已启动科创板上市准备工作，并计划在2019年完成Pre-PO轮融资和整体改制工作，预计将在2020年正式申报科创板上市材料。

紫光展锐2018年度实现营业收入73.03亿元，净利润2.55亿元，总资产384.49亿元，其中所有者权益为217.83亿元。

展锐是国内两家手机芯片平台公司之一，拥有2G/3G/4G/5G的完整手机芯片技术，国内拥有4500余名员工，其中90%以上是研发人员。

来源 澎湃新闻

讣告

中国半导体行业杰出的专家、学者陈贤同志于2020年5月27日在北京因病逝世，享年74岁。

陈贤同志，出生于1945年12月18日，中共党员，毕业于北京大学，本科学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。1970年3月至1986年7月任北京大学微电子学研究所主任；1986年7月至1993年5月任国家电子工业部副部长，机械电子工业部处长；1993年5月至1996年5月历任中国电子信息产业集团公司微电子事业部经理、规划部经理；1996年5月至2002年2月任华越微电子有限公司董事长、总经理；2002年2月至2006年1月任中国电子信息产业集团公司信息技术研究院战略部主任，中国华大集成电路设计集团有限公司董事，上海华虹(集团)有限公司董事；2006—2008年担任中国半导体行业协会副秘书长；2009—2012年担任中国半导体行业协会秘书长；2013—2017年担任中国半导体行业协会副理事长；2018年至今担任中国半导体行业协会专家委员会副主任。

陈贤同志一生为我国半导体产业做出了卓越的贡献，是我国半导体行业知名的专家、学者，为人宽厚、工作积极、勇于担当。他的逝世是我国半导体行业的损失，他的优秀品质将成为业界人士的楷模和典范。

中国半导体行业协会秘书处

二〇二〇年三月二十七日

关于召开“SEMICON China 2020”的通知

受新型冠状病毒疫情影响的影响，为保障广大展商、观众及嘉宾的健康与安全，SEM推迟了原定于2020年3月18日至20日举行的SEMICON/FPD China 2020。对此造成的不便，SEM感谢您的理解和支持！

经与相关各方努力沟通、协调，并充分考虑参展商、赞助商及嘉宾对原场地的熟悉程度和便利性，在上海市政府大力支持下，我们克服了极大展商会期导致展览场地紧缺难题，争取到了比较理想的调整档期，请大家预留时间：

展览日期：2020年6月27日-29日

同期会议：2020年6月26日-29日

展览及会议地点：上海浦东新国际博览中心及上海浦东嘉里大酒店

随着新型冠状病毒感染确诊人数持续下降，疫情控制形势不断好转，我们将继续与上海市政府及相关机构紧密配合，确保新档期的SEMICON/FPD China 2020安全和成功，并取得一如既往的丰硕成果！同时SEM将尽快联系大家，用专业的服务、尽最大的努力协助参展展商和赞助商顺利过渡到新档期。

观众注册：

2020年5月29日前完成观众预登记，为您提前邮寄胸卡（国际及港澳台观众请凭注册ID现场快速领取），优先入场，免您半小时现场排队等候！

【扫码登记并抽奖】扫描下方二维码关注SEMChina微信，点击右上角“观众登记”，2020年6月15日前完成观众预登记后，可立即参与预登记观众抽奖活动！



来源 SEM